

8410 HS

产品信息



用于集成电路片嵌入智能卡的热反应薄膜

产品描述

tesa® HAF 8410 HS 是一款基于活性酚醛树脂与腈橡胶的热反应型双面棕色胶带。

- *可靠的芯片模块粘接
- *适用于PVC,ABS,PET及PC卡
- *在所有常见注入线上都有良好的操作性
- *优秀的抗老化性
- *高橡胶含量，具有永久的柔韧性

应用

tesa® HAF 8410 HS 专为芯片模块嵌入到智能卡的应用设计，它也适用于所有耐热材料如金属、玻璃、塑料、木材和纺织品的粘接，例如离合器摩擦衬垫。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|
| • 基材 | 无 | • 总厚度 | 60 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丁腈橡胶/酚醛树脂 | • 颜色 | 琥珀色 |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 | | |

属性/性能值

- | | |
|----------------|----------------------|
| • 粘接强度 (动态剪切力) | 12 N/mm ² |
|----------------|----------------------|

附加信息

智能卡应用的技术参数推荐：

以下是所推荐的机器运行的参数。请注意，最佳工艺参数主要取决于机器的类型，特别是卡身和芯片模块的材料以及客户的要求。

1. 预贴：

在预贴过程中，胶带贴在模块带上。这个步骤可以在线或者离线进行。预贴过程不会影响胶带的存放寿命。预贴模块带可以保存和胶带一样的时间。

机器设定：

- *温度 120 – 140 °C
- *压力 2 – 3 bar
- *时间 2.5 m/min

2. 模块嵌入：

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=08410>



8410 HS

产品信息

附加信息

在模块嵌入过程中，预贴模块是模块带上模切件定位到卡腔内，然后加热永久固定到卡身里。根据注入线的类型，可以使用单步或者多步操作。目前，大部分注入线机器都是用多步热压操作。

单步操作-机器设定

*温度¹ 180 - 200 °C

*压力 65 – 75 N/module

*时间 1,5 s

多步骤操作 (2次或以上加热贴合) -机器设定 :

- 温度¹ 180 – 200 °C
- 压力 65 – 75 N/module
- 时间 (每个步骤) 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 s

温度建议参考热压头内测量所得，不同的温度设置是推荐用于不同的卡片材料：

PVC and ABS 180 – 190 ° C

PET and PC: 180 – 190 ° C

粘贴强度值是在标准实验室条件下获得 (平均值)。这个值是每个生产批次检查下的测隙极限(材料: 铝刻蚀试验样品/粘合条件：温度=120°C，P =10bar; 时间 =8分钟)

为达到最佳的粘接强度，粘接表面应干净干燥。储存条件符合tesa® HAF保质期原则

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=08410>